

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成20年5月22日(2008.5.22)

【公開番号】特開2002-307427(P2002-307427A)

【公開日】平成14年10月23日(2002.10.23)

【出願番号】特願2001-115604(P2001-115604)

【国際特許分類】

B 2 9 B	7/46	(2006.01)
B 2 9 B	7/90	(2006.01)
C 0 8 J	3/20	(2006.01)
C 0 8 K	3/00	(2006.01)
C 0 8 L	71/12	(2006.01)
C 0 8 L	77/00	(2006.01)
B 2 9 K	71/00	(2006.01)
B 2 9 K	77/00	(2006.01)
B 2 9 K	105/06	(2006.01)

【F I】

B 2 9 B	7/46	
B 2 9 B	7/90	
C 0 8 J	3/20	C E R Z
C 0 8 J	3/20	C E Z
C 0 8 K	3/00	
C 0 8 L	71/12	
C 0 8 L	77/00	
B 2 9 K	71:00	
B 2 9 K	77:00	
B 2 9 K	105:06	

【手続補正書】

【提出日】平成20年4月4日(2008.4.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】二軸同方向回転押出機を用い、結晶性樹脂100重量部又は結晶性樹脂がマトリックスである組成物100重量部を、無次元押出量 $D/LQ = 0.004 \sim 0.025$ で、且つ回転数が $300 \sim 900 \text{ rpm}$ で溶融混練し、ダイプレート出口の樹脂温度Tが結晶性樹脂の融点 $+20 \sim 120$ で、且つダイ部の平均滞留時間tが3秒以上45秒未満で押出すことを特徴する溶融混練方法。

【請求項2】樹脂組成物が、ポリアミド系樹脂90～10重量部のマトリックスとポリフェニレンエーテル10～90重量の組成物であり、且つダイプレート出口の樹脂温度が290～350であることを特徴とする請求項1に記載の溶融混練方法。

【請求項3】樹脂組成物が、ポリアミド系樹脂99～30重量部と強化材1～70重量部の組成物であり、且つダイプレート出口の樹脂温度が290～330であることを特徴とする請求項1に記載の溶融混練方法。

【請求項4】樹脂組成物のダイ部の平均滞留時間tとダイプレート出口の樹脂温度Tの関係が

3秒 $t \leq 17$ 秒の範囲では、 $290 \leq T \leq 350$
17秒 < $t \leq 45$ 秒の範囲では、 $290 \leq T \leq (374 - 1.43t)$
にあることを特徴とする請求項2に記載の溶融混練方法。

【請求項5】樹脂組成物のダイ部の平均滞留時間 t とダイプレート出口の樹脂温度 T の関係が

3秒 $t \leq 17$ 秒の範囲では、 $290 \leq T \leq 330$
17秒 < $t \leq 45$ 秒の範囲では、 $290 \leq T \leq (354 - 1.43t)$
にあることを特徴とする請求項3に記載の溶融混練方法。

【請求項6】ダイ部として、ホットカット用ダイ、もしくはアンダーウォーター用ダイを使用することを特徴とする請求項1、2、3、4、および5のいずれかに記載の溶融混練方法。

【請求項7】ダイ部として、ストランドカット用ダイを使用することを特徴とする請求項1、2、3、4、および5のいずれかに記載の溶融混練方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0005

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0005】

即ち本発明は、二軸同方向回転押出機を用い、結晶性樹脂100重量部、又は結晶性樹脂がマトリックスである組成物100重量部を、無次元押出量 $D_L Q = 0.004 \sim 0.025$ で、且つ回転数が $300 \sim 900 \text{ rpm}$ で溶融混練し、ダイプレート出口の樹脂温度 T が結晶性樹脂の融点 + 20 ~ 120 で、且つダイ部の平均滞留時間 t が3秒以上45秒未満で押出すことを特徴する溶融混練法に関する。